



S-Takaya電子工業株式會社

總公司 719-0301 日本岡山縣淺口郡里庄町里見3121-1

電話：(+81)865-64-4131 傳真：(+81)865-64-4474

詳情請點閱以下網址

<https://www.s-takaya.co.jp>

S-takaya

搜索



(2024.7)

TAKAYA

Contribute To The Future Of Society

憑藉我們獨特培育的**技術與知識**，
利用最先端的技術，
對社會的**未來**有所貢獻。

“S” 包含

公司名稱中的“S”反映著多樣化的時代，賦予著許多涵義。

因此，我們創辦（Start）了這樣的公司。



SATOSHO
里庄町



SURPRISE
驚喜



SMART
智慧



SPECIAL
獨一無二



SEEK
追求



SPICES
刺激



SMILE
微笑



SCOOP
歡樂

1979年8月 — 2021年10月

更名為“S-TAKAYA ELECTRONICS INDUSTRY CO.,LTD.”

Business 事業介紹

我們開發獨創的LSI裝置和模組並構建生產系統

我們S-TAKAYA持續藉由LSI (大規模集成電路) 裝置和模組的開發和製造為資訊化社會的發展做出貢獻。

在不斷發展的社會中, 客戶的要求是多樣化的。

我們製造獨創的 LSI 設備和產品, 構建生產系統以及製造客製化設備和治具等, 不斷創造和提供各種解決方案。

SERVICE



LSI Device和模組

LSI DEVICE / MODULE

我們製造和檢查各式各樣的模組BGA・COF・圖像感應器等, 用於車載、醫療和智慧手機。



雷達模組

RADAR MODULE

我們根據客戶的需求和環境提供從雷達模組的設計開發到量產的客製化服務。



產業用設備的開發販賣

DEVELOPMENT OF AUTOMATION EQUIPMENT

我們提供客戶製造時最合適的自動機台, 省人化/省力化/小型化以及研究開發時所需的特殊設備, 也能提供原廠委託設計的服務, 請隨時與我們聯繫。



環保產品

ENVIRONMENTAL

我們提供環保的產品和服務。

Reason 選擇S-TAKAYA的理由

持續因應客戶的需求

本公司以創業40多年的歷史累積的各種半導體組件的製造技術和專業知識快速並有誠意地滿足客戶的需求。



LSI Device Module

LSI Device/
模組

我們憑藉豐富經驗和技術能力滿足客戶各式各樣的需求。

隨著電子化的急劇發展，LSI device和模組需要具有更高的功能和更小的尺寸。

我們為了滿足這些市場需求，融合技術、設備和系統，安裝最新設備，

構建高效的生產體制，衍生出最新的LSI device和模組。

生產體制

我們可以提供從晶圓測試到模組安裝的一站式服務。憑藉我們獨特的技術，支持客戶構建所需的生產體制。

01 客戶提供需求



我們依照客戶的需求生產產品。
歡迎隨時與我們聯繫。

02 晶圓測試



產品晶圓測試。

03 研磨/切割



背面研磨，雷射開槽，晶圓切割。

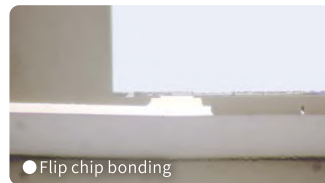
04 LSI device的後段組裝



● Die bonding



● Wire bonding/Bump bonding



● Flip chip bonding



● 成型 (molding)

我們用獨特的技術組裝

05 模組組裝



進行產品的實裝並進行確認。

06 最終測試/外觀檢查



出貨前測試，詳細檢查性能。

07 出貨



從下單到出貨的一站式服務

OP1 分析解析服務

OP2 環境RA試驗

產品應用領域



相機模組
圖像傳感器



特殊mold成型
(透明膠模)



TAIKO® wafer的
rib除去、dicing



模組/MCM



特殊成型
(部分外露模具)



Chip full test



COF
(Chip On Film)



特殊成型
(預成型空心包裝)



Chip的全數6面外觀檢查及
KGD (Known Good Die)



BGA (Ball Grid Array) /
塑料封裝



Wire bump、Dicing
及自動測定檢查

Radarmodule

雷達模組

我們擁有從開發到量產的一站式的技術能力

雷達模組從設計、開發到量產可一氣呵成地滿足客戶的式樣要求。

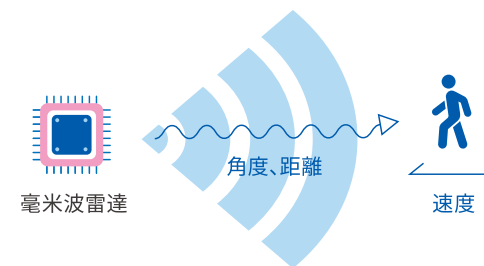
雷達的優勢

30GHz-300GHz頻率的毫米波具有較強的直線特性，

受雨霧等外界環境因素的影響較小。

利用這種毫米波進行傳遞的設備稱為毫米波雷達。

利用毫米波雷達，可以取得物體的距離、角度、速度等數據。



	雷達	紅外線	超音波	相機	LIDAR
近距離檢測 (2m以下)	●	●	●	●	●
中距離檢測 (2-30m)	●	●		●	●
遠距離檢測 (30m以上)	●				●
距離檢測	●	●		●	●
速度檢測	●		●		●
角度檢測	●	●		●	●
環境耐性	●				
產品設計自由	●				
尺寸	●	●	●	●	
價格	●	●	●	●	

毫米波雷達可以用在什麼地方？



防犯措施

可以透過過辨識人物和距離而啟動警報器及監視器，是今後倍受矚目的防犯措施。



安全偵測

在廁所、浴室等難以安裝監視器的場所，在考量隱私的情況下，可以偵測突發疾病和異常情況的發生。



嬰兒和看護場所的監控

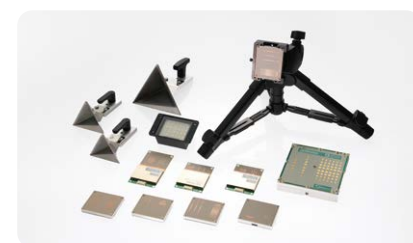
可以透過偵測床上的呼吸和脈搏來識別病情狀況的變化，防止窒息等事故的發生。



節能裝置

透過燈光和家電的結合，雷達可以藉由偵測人體來自動控制電源，達到節能省電的效果。

關於各種評估元件



可以藉由使用評估元件立即開始評估您的雷達模組。透過使用評估元件找出問題點，可以降低試作生產和評估的成本。

評估元件系列一欄

※1 ▲為可客製化量產

系列	MMIC	頻率	距離	速度	角度	轉量※1
ST24ZS2系列	Infineon Technologies	24GHz	●			▲
T14RE系列	Texas Instruments	79GHz	●	●	●	●
T68PE系列	Texas Instruments	60GHz	●	●	●	●
T68PE2系列	Texas Instruments	60GHz	●	●	●	●
T18PE系列	Texas Instruments	76GHz、79GHz	●	●	●	●
Atlas24系列	Analog Devices	24GHz	●	●	●	▲
Atlas7xG系列	Analog Devices	76GHz、79GHz	●	●	●	▲
Eris系列	NXP Semiconductors	79GHz	●	●	●	▲
Eris2系列	NXP Semiconductors	76GHz、79GHz	●	●	●	▲
Athena60系列	Asahi Kasei Microdevices Corporation	60GHz	●	●	●	●
Athena79系列	Asahi Kasei Microdevices Corporation	79GHz	●	●	●	▲

Facility & Original product

產業用設備的
開發販賣

我們為製造現場的創新做出貢獻

我們用半導體組裝現場所培育出的感性，給予顧客製造時最合適的自動化設備。

客製化測試處理器DX系列

這是一種全自動測試處理器，運輸部和檢查部為分離的結構。
我們還可以根據相機鏡頭模組的檢測內容提供各種測試元件。



測試元件使用實例

我們根據客戶的工作和檢查環境客製化測試元件。

DX1327

用於相機模組的行程行為測量

- 3階段 (6dut) 類型
- 測試元件
VCM行程檢查/OIS (光學防手震) 特性檢查



DX1533

用於相機模組向下特性檢測

- 3階段 (6dut) 類型
- 測試元件
無限遠特性檢查/黑痕檢查/白痕檢查



DX2299

用於超廣角相機模組

- 2階段 (4dut) 類型
- 測試單元件
光學中心檢查/黑痕檢查



特徵
FEATURE

- 可以根據各種作業和檢查內容配置測試元件。
- 其他的package可以在洽談後提供我們的方案。
(CSP/BGA/QFN/QFP等)
- 作業輸送段的標準化
- Handler形狀：W1760 x D1230 x H2280 (mm)
- 測試元件尺寸：W 940 x D700 x H1000 (mm)
- 處理能力：300 - 500 (UPH)
※取決於測試元件和檢查細節。

其他設備開發



相機模組全自動測試機



通用loader/Unloader



雷射焊錫機



複合膠塗佈INLINE機

Environmental

環保產品

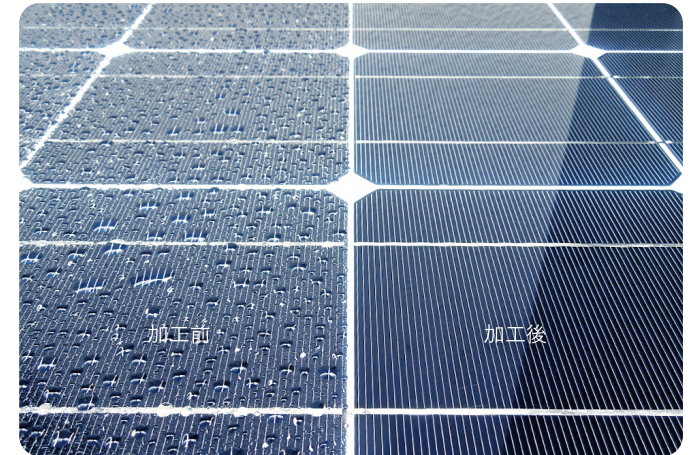
為了留給未來的下一代“美麗的地球”，我們提出了我們能做的事情

太陽能板清潔



PV Iron Remover (太陽能板除鐵劑)

PV Iron Remover可有效率地去除囤積在太陽能板上的鐵粉。



PV Hydro Coat (太陽能板塗層)

PV Hydro Coat有效利用雨水，防止太陽能板表面污垢堆積導致發電量下降。



PV scale remover

此為能將強力附著在太陽能板上混有scale,鐵粉與礦物質的頑強污垢去除的清潔劑。



PV SP cleaner

此為能去除樹液・花粉・鳥糞・煤煙等有機物髒污的清潔劑。



Sustainability

SDGs

我們透過環保製造實現碳中和

永續發展目標活動

01 ENVIRONMENT 善待地球



我們基於ISO14001（持續獲得認證20年）從選材、製造到廢棄的過程對環境的影響減少到最小，致力於實現淨零排放。

02 AFFLUENT 朝向繁榮的社會



我們以擁有40多年的歷史技術為基礎，製造各種模組產品，為豐富的資訊社會做出貢獻，這些產品能夠符合目前多樣化的時代。

03 SAFE AND RELIABLE 邁向一個安心和安全的社會

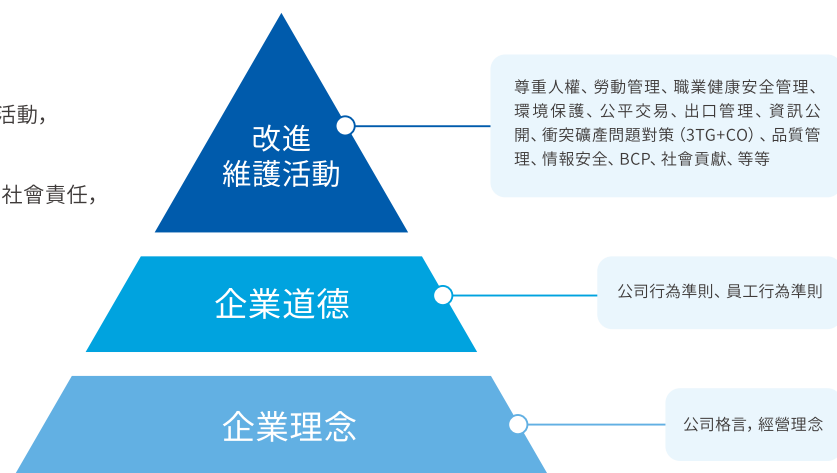


我們透過開發和利用可應用於醫療、防災和車輛等各種與人們生活息息相關的模組產品，為建立安全、安心的社會做出貢獻。

CSR活動

在S-TAKAYA，根據我們的公司座右銘和使命宣言，所有員工都遵守公司和員工的行為準則，促進健康的商業活動，為社會的永續發展做出貢獻。為實現此目標，我們不僅要遵守法律，還要履行我們作為優秀企業公民的社會責任，並與所有相關人員建立信任關係，因而提升公司價值。

在S-TAKAYA的CSR活動中，遵循全球準則和原則。
ISO26000（企業社會責任全球指南）/JIS Z26000《社會責任指南》/
SDGs《永續發展目標》/RBA（責任商業聯盟）等行業行為準則



各種政策

環境政策

由於S-TAKAYA電子工業株式會社開發、設計、製造和銷售半導體、電子零件、電器電子機械器具和相關產品。我們有責任製造對地球環境友善的產品。我們根據我們的行為準則和基本環境理念致力於環保活動。

品質理念

“秉持著品質第一的理念”
Quality First in Heart and Mind

情報安全政策

S-TAKAYA位於自然災害較少的岡山縣，生產和檢查各種封裝的IC和LSI設備產品。此外，我們秉持多年累積的專業知識，開發、製造和銷售我們獨特的產品和電氣電子設備。在我們的業務中，資訊安全為很重要的一環，尤其需要加強對生產管理系統、客戶資料和技術資料的資料安全管理。為了透過半導體設備產品的開發和製造繼續為信息社會的發展做出貢獻，我們導入了ISMS並實踐了高度安全的管理，並堅持以下方針來持續改進。

Company

公司簡介

來自總裁的問候

建立豐富的生活，創造有價值的職場，
以實現舒適的社會為目標

自1979年成立以來，秉持著這些座右銘和使命宣言，我們持續不斷地為LSI設備和模組製造商為社會的永續發展做出貢獻。2000年代初期，隨著國內廠商加速全球化，我們將業務版圖擴展到海外。憑藉多年經驗累積的技術能力，我們將公司發展成為世界最高水準的相機模組製造商。因此，我們成功地與國內外市場的強大公司建立了合作業務關係。我們製造業周圍的環境一直面臨困難，但是，我們相信“日本製造”的重要性一定會再次受矚目。

我們將繼續強調“品質第一”，並通過多元化管理來提高我們的可靠性和公司價值。這旨在提高我們的競爭力，實現理想的公司，並與所有利益相關者共同成長。我們公司和全體員工，藉由重視這種商業精神不斷發展壯大，我們不斷發展我們的業務多方位，願意接受新時代和新要求的挑戰。

總裁 Futoshi YUNOKI,

公司簡介



總公司

- 公司名稱
S-TAKAYA ELECTRONICS INDUSTRY CO.,LTD.
- 創立
1979年8月15日
- 董事長
柚木太志
- 資本額
1億日元
- 員工
555人（截至2024年4月）
- 銷售收入
97.1億圓（2024年3月）
- 產品與服務
半導體device・module產品以及產業用設備的開發・製造・販賣
雷達模組的設計・開發・製造
- 地點
〒719-0301
岡山縣淺口郡里庄町里見3121-1
電話：+81-865-64-4131
傳真：+81-865-64-4474



關係企業

- 公司名稱
SAIGON STEC CO.,LTD.
- 設立
2007年9月
- 資本額
資本額6,100,000美元
（夏普公司51%，S-TAKAYA ELECTRONICS INDUSTRY CO.,LTD. 49%）
- 產品與服務
相機鏡頭模組組裝/檢測
- 地點
越南社會主義共和國平陽省 VSIPII 工業園區
電話：+84-274-363-5290
傳真：+84-274-363-5295



歷史

1979

- | | | |
|-------|-----|--------------|
| 1979年 | 8月 | 設立 資本額2.5億日元 |
| 1980年 | 4月 | 開始IC/LSI封裝測試 |
| 1981年 | 6月 | 增資至2.8億日元 |
| | 12月 | 開始晶圓測試 |
| 1983年 | 3月 | 第二棟大樓竣工並開始營運 |
| | 4月 | 開始TCP製程生產 |
| 1984年 | 6月 | 增資至3億日元 |
| 1985年 | 4月 | 開始COB製程生產 |
| 1988年 | 5月 | 開始Chip生產 |
| 1989年 | 5月 | 第3棟大樓竣工並開始營運 |

1989

1990

- | | | |
|-------|-----|-----------------|
| 1991年 | 1月 | 第4棟大樓竣工並開始營運 |
| | 4月 | RCJ認證, 電子零件認證登錄 |
| 1992年 | 10月 | 開始生產CCD製程 |
| 1993年 | 7月 | 取得ISO9001認證 |
| 1996年 | 8月 | 開始生產CSP製程 |
| 1997年 | 2月 | 開始晶圓背面研磨 |
| 1998年 | 11月 | 開始生產COF |
| 1999年 | 9月 | 取得ISO14001認證 |

1999

2000

- | | | |
|-------|-----|-----------------------------|
| 2000年 | 6月 | 增資至3.1億日元 |
| | 8月 | 第5棟大樓竣工並開始營運 |
| 2001年 | 10月 | 開始相機模組生產 |
| 2002年 | 11月 | 開始生產IC卡 |
| 2003年 | 5月 | 開發技術中心（舊：矢掛工場）開始營運 |
| 2006年 | 3月 | 開始One-Seg 模組生產 |
| 2007年 | 9月 | 開始晶圓CSP生產 |
| 2008年 | 8月 | SAIGON STEC（100%子公司）開始營運 |
| | 10月 | 開始相機元件生產 |
| 2009年 | 3月 | 開始生產太陽能模組生產
取得ISO27001認證 |

2009

2010

- | | | |
|-------|-----|--|
| 2012年 | 10月 | 開始觸控面板模組組裝生產 |
| 2014年 | 6月 | 矢掛開始營運太陽能發電廠 |
| 2015年 | 5月 | 總公司開始營運太陽能發電廠 |
| | 9月 | 停止生產IC卡 |
| | 10月 | 取得ISO/TS16949認證 |
| 2018年 | 5月 | 將SAIGON STEC 51%的股份轉讓給SHARP Corporation |
| 2019年 | 7月 | 雷達模組生產開始 |
| 2020年 | 3月 | 從SHARP Corporation所擁有的股份全部轉讓給本公司 |
| | 6月 | 資本額變更為1億日元 |
| 2021年 | 3月 | 開發技術中心（舊：矢掛工場）與總公司統合，並還回TAKAYA Corporation |
| | 6月 | 醫療機器製造業登錄 |
| | 10月 | 公司名稱由“Sharp TAKAYA ELECTRONICS INDUSTRY CO.,LTD.”變更為“S-Takaya電子工業株式會社” |
| 2022年 | 12月 | mold package (lead frame產品) 生產停止 |
| 2023年 | 8月 | 獲得笠岡地區消防組合 救MARK認定事業所的認證 |
| 2024年 | 1月 | 獲得SPORTS YELL COMPANY 2024年認證 |
| | 3月 | 獲得健康經營優良法人2024（大規模法人部門）認證 |
| | 5月 | POWER半導體生產開始 |